



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 05 月 02 日

Application Date

申 請 案 號: 092208079

Application No.

申 請 人: 財團法人工業技術研究院

Applicant(s)

局 Director General



發文日期: 西元_2003_年__7__月_29__日

Issue Date

發文字號: 09220765680

Serial No.





写同 写同 写同

申請日期	:	IPC分類
申請案號		
(以上各欄	由本局填	新型專利說明書
	中文	用於奈米轉印之平行度調整裝置
新型名稱	英文	
	姓 名(中文)	1. 鍾永鎮 2. 林家弘 3. 陳釧鋒
=	姓 名 (英文)	1. 2. 3.
創作人 (共6人)	國籍(中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW 3. 中華民國 TW
()(0)()	住居所(中文)	1. 高雄縣燕巢鄉角宿村寶頂東街3號 2. 新竹市東區復中里3鄰民權路167號 3. 台北縣土城市峰廷里8鄰延吉街217巷11弄4號1樓
	住居所 (英 文)	1. 2. 3.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 財團法人工業技術研究院
	名稱或 姓 名 (英文)	1.
三	國籍(中英文)	1. 中華民國 TW
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 新竹縣竹東鎮中興路四段195號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	(營業所) (英 文)	1.
	代表人(中文)	1. 翁政義
	代表人(英文)	l.

申請日期:		IPC分類	_				
申請案號:							
(以上各欄	(以上各欄由本局填註) 新型專利說明書						
_	中文						
新型名稱	英文						
	姓 名 (中文)	4. 許嘉峻 5. 馮文宏 6. 陳明祈					
÷		4. 5. 6.					
(美)作人 (共6人)	國 籍 (中英文)	4. 中華民國 TW 5. 中華民國 TW 6. 中華民國 TW					
(5000)	住居所(中文)	14 甘吸士位美厄迪南田一郡南田改9张					
	住居所 (英文)	4. 5. 6.					
	名稱或 姓 名 (中文)						
	名稱或 姓 名 (英文)						
゠	國籍(中英文)	1 .					
建請人 (共1人)	住居所 (營業所) (中 文)						
!	住居所 (營業所) (英 文)						
	代表人(中文)						
	代表人 (英文)						
17188 T 64 B	≅ ntd						

四、中文創作摘要 (創作名稱:用於奈米轉印之平行度調整裝置)

本案代表圖:第1圖

英文創作摘要 (創作名稱:)



。 四、中文創作摘要 (創作名稱:用於奈米轉印之平行度調整裝置)

1	平行度調整裝置	1 0	轉印單元
11	模具	12	第一模板
13	奈 米 結 構	1 4	驅 動 源
15	導引桿	20	承載單元
21	基 板	22	吸 附 板
2 3	可成形材料層	2 4	彈 性 膜
25	流體	2 6	第二模板
27	平行度調整機構	3 1	定位平台
41	模具冷卻器	42	基板冷卻器
<u>- 1</u>	加熱器	5 5	壓力感測器
X200			

英文創作摘要 (創作名稱:)



·一、本案已向			
.國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第一百零五條準用 第二十四條第一項優先權
			7/ — G 1// 1/ - X 1// 7/10
		無	
			•
75 75 75 75 75 75		1 tr > A*A*	75 de 145
二、□主張專利法第一百	事零五條準用第二十	五條之一第一項	俊 无權:
申請案號:		無	
日期:		/////	
三、主張本案係符合專利	月法第九十八條第一	項□第一款但書	或□第二款但書規定之期間
日期:			
ц Ж .			
			- e
			1 .
	91		
			•••

五、創作說明(1)

【新型所屬之技術領域】

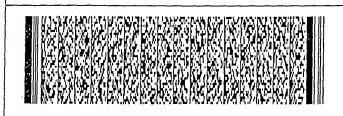
本創作係一種用於奈米轉印之平行度調整裝置,尤指一種作動簡單且可即時響應之平行度調整裝置。

【先前技術】

隨著積體電路的線寬需求越來越窄,利用傳統光微影(Photo Lithography)製程進行加工時,若所設計之線寬低於光源之波長(Wave Length),則將因受限於光之繞射極限,使得進行更小尺寸加工的困難度倍增,除此之外,現今在微奈米特徵結構上也尚未發展出一適當的量產加工技術,致使奈米轉印技術(Nano-Imprint Lithography,到L)因而產生,其除了能達到更小線寬的需求外,亦有加工快速、成本低、大面積加工等優點,可符產業上之量產需求。

奈米轉印技術之作用原理係指利用轉印力將模具上所預先設計之奈米結構特徵轉印至一塗佈於基板

(Substrate)上的可成形材料層,該可成形材料層一般係選自如聚甲基丙醯酸脂 (PMMA)等高分子聚合物材料,以藉其成形繼而進行後續半導體製程,而達至所需的奈米等級線寬結構。第 3A至 3C圖所示即為奈米轉印技術之動作流程圖,其係藉由昇溫一轉印一降溫一脫模步驟,以完成整個轉印程序,第 3A圖之昇溫動作係在於使該基板 21上所塗佈之可成形材料層 23達至轉印所需之操作溫度;轉印動作則如第 3B圖所示,利用固定於第一模板 12且具有奈米結構 13之模具 11,並藉一驅動源 14之驅動而向固定於第二模板 26之





五、創作說明 (2)

基板 21移動,當模具 11與基板 21上之可成形材料層 23接觸後即開始施壓,俾使該模具 11上之特徵轉印於該可成形材料層 23上;再令該可成形材料層 23降至適當溫度後,如第3C圖所示,使該模具 11與可成形材料層 23分離而進行脫膜,即完成此奈米轉印技術之轉印程序。

, 其 進 行 轉 印 動 作 時 該 模 具 與 基 對此一新式技術而言 板間之平行度及轉印力均匀與否俱為決定轉印品質之重要 ,且由於該模具與基板係分別固定於該第一模板與第 其轉印力之均勻性又繫於該第一 二 模 板 上 , 因 此 ,故只要轉印過程之施壓均勻性與平行 模板的施壓均勻性 或因零件加工與組裝不良造成模具與基板間 度稍有偏差 ,即可能影響其轉印精度,甚至損壞該基板 之平行度偏移 或該模具上的精細奈米結構;同時,若相較於傳統之熱壓 成形技術(Hot Embossing),該奈米轉印技術由於轉印精 度要求更高,其平行度與均匀施壓之要求勢必得更為嚴 格,就現有轉印模壓設備之製造加工與組裝精度而言,顯 然已無法達至奈米轉印的平行度及均勻轉印力要求

以第 4圖所示之美國專利第 5,993,189號專利為例,該項習知技術係以一上載台 61固定具有奈米結構之模具 63,並以一下載台 62承載基板 64,該下載台 62係以如圖所示之導柱 65為導引,而向上施壓以完成轉印之動作,此轉印裝置中並未設計有平行度調整裝置,極易由於模板與導柱 65等零件之加工誤差或組裝不良,形成模具 63與基板 64間平行度不佳之品質問題;此外,如第 5圖所示之 PCT專利第

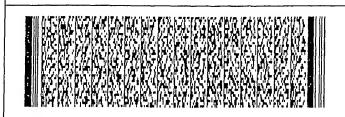




五、創作說明(3)

WO0169317號案,其轉印模具71與基板72之後方係分別與一獨立的油壓缸活塞73、74連接,以藉該活塞73之作動令該模具71與基板72產生接觸並施壓,而完成轉印動作,並藉由該油壓缸75內側之0形環76(0-Ring)的有限彈性變形,於其兩者未平行接合時進行一平行度調整,惟此裝置內係以兩油壓缸75、77作動,將導致結構及驅動複雜度之增加,且其油壓系統亦有控制響應不佳的缺點。

因此,如何開發一種可用於奈米轉印之平行度調整裝置,以補償製造加工及組裝精度的誤差,進而可提昇均勻





五、創作說明 (4)

施壓性並大幅提昇奈米轉印品質,同時,兼具有結構簡單、成本低廉、即時響應與低作動複雜性等功效,確為此相關研發領域所需迫切面臨之量產課題。

【新型內容】

因此,本創作之一目的即在提供一種可兼及奈米轉印之均匀施壓性的平行度調整裝置。

本創作之再一目的即在提供一種不致損及模具與基板的平行度調整裝置。

本創作之又一目的即在提供一種結構簡單且成本低廉的平行度調整裝置。

本創作之另一目的即在提供一種可即時響應的平行度調整裝置。

本創作之復一目的即在提供一種無需前置作業且作動簡單的平行度調整裝置。



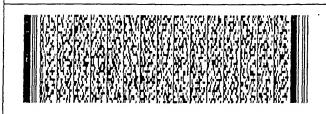


五、創作說明 (5)

度。

若該平行度調整機構係接置於該第一模板上,則其係固定於該第一模板與該轉印用模具間,而若該平行度調整機構係接置於該第二模板上,則其係固定於該第二模板與該基板間,以分別於受壓時調整該轉印用模具與基板間之平行度;其中,前述平行度調整機構之彈性膜係為橡膠平行度;其中,前述平行度調整機構之彈性膜係為橡膠、塑膠等高分子材料或其他可撓性結構,而其所包覆之流體則可為任意液體或氣體。

此外,該平行度調整機構復包括一用以感測其受壓壓力的壓力感測器,以進行一即時壓力感測,並藉一預先設的壓力一時間控制曲線控制該奈米轉印之過程;同時,該轉印單元與承載單元復可分別接置於一大面積的定位平台,以加強轉印過程中之水平定位效果。





五、創作說明 (6)

【實施方式】

本創作之用於奈米轉印平行度調整裝置1的較佳實施例係如第1圖所示,其係以一模具11、第一模板12與驅動源14搭配組合成轉印單元10,並藉由複數根導引桿15之導引而使其可向承載單元20移動,其中,該模具11上係形成有轉印之奈米結構13;該承載單元20則係包含一置於定位平台31上之第二模板26,該第二模板26內部係裝設一可承受高壓且密封的彈性膜24,其膜內係充填有流體25,藉該彈性膜24及其包覆之流體25組成一平行度調整機構27;同時,該承載單元係設置一塗佈有可成形材料層23之基板21,其係藉由一吸附板22之真空吸附力而吸附於上,並令該可成形材料層23朝向該模具11之奈米結構13表面。

該吸附板 22上係具有細孔 (未圖示), 其係連同該固定於其上的基板 21一併置於該容設於第二模板 26間的彈性膜 24上, 以利用該定位平台 31的水平定位能力進行該基板 21 與模具 11間之精準對位 (Alignment), 提昇奈米轉印之精度; 而該第一模板 12上係分佈配置有複數個加熱器 51, 其。係可與分佈於該基板 21與模具 11間的快速加熱單元 (未圖示), 一併對該基板 21上之可成形材料層 23昇溫至一預定操作溫度,以進行轉印動作,而該第一模板 12上亦同樣配置有模具冷卻器 41,該吸附板 22上則配置有基板冷卻器 42,其均係用以於轉印完成後,對該相互接觸之模具 11與基板 21降溫以進行脫模。

此一平行度調整裝置1中,復如第1圖所示設置有一壓





五、創作說明 (7)

力感測器 55, 其係裝設於該平行度調整機構 27, 以感測奈米轉印過程中,該模具 11與可成形材料層 23接觸時之受壓力,以藉此一即時壓力監側進行轉印控制,其作法可藉由一預先規劃之壓力 -時間操作曲線,於該模具 11與可成形材料層 23接觸且壓力上升至一定值時,令兩者間之壓力保持於該定值而維持數秒,並於完成轉印後脫模卸壓,其壓力與時間之數值關係可視轉印材料與精度需求而藉實驗取得;惟第 1圖所示之壓力感測器 55裝設位置僅為本較佳實施例之設計,其位置並無一定限制,僅需裝設於可感測該施壓過程之壓力變化的位置即可。

形式平行度調整機構 27中之彈性膜 24,係以橡膠、塑膠等高分子材料或其他可撓性結構所組成,而其所包覆之流體 25則可為任意之液體或氣體;同時,該基板 21上之可成形材料層 23一般係指一高分子聚合物材料,亦可為其他可成形之金屬與非金屬材料,而該模具 11與基板 21均係以可成形之金屬與非金屬材料,所有分別吸附而定位以其空吸附力、機械力等方式分別吸附而定位於該第一、第二模板 12、 26上;此外,用以進行轉印過程之驅,第14,係為一線性馬達與油壓缸之組合。馬達與滾珠導螺桿或其他構件之組合。

因此,利用本創作之平行度調整裝置 1,即可進行如下所述之奈米轉印步縣:其係先以該第一模板 12所配置的複數個加熱器 51及分佈於該基板 21與模具 11間的快速加熱單元 (未圖示),對該基板 21上之可成形材料層 23昇溫至一轉印操作溫度;復利用該轉印單元 10之驅動源 14驅動該第





五、創作說明 (8)

一模板 12及固定於其上之模具11,以藉該導引桿 15控制其 向該承載單元20之方向移動;當該轉印單元10與承載單元 20接觸,並令該模具11上之奈米結構13與該基板21上之可 成形材料層 23接觸後,即可進行施壓,此時由於設置在該 承載單元20之彈性膜24具有可撓性,將隨著該轉印單元10 之施壓方向而進行一被動式平行度調整,致使該模具11與 基板 21於接觸之瞬間即可達至理想的平行度,進而可於轉 印過程中維持平行度之需求,並可藉該彈性膜24所包覆之 流體 25, 使其承受均匀之施壓力;而當該驅動源 14緩緩施 壓 時 , 該 位 於 彈 性 膜 24上 之 壓 力 感 測 器 55將 進 行 即 時 壓 力 檢 測 , 以 藉 預 先 之 壓 力 規 劃 控 制 並 執 行 轉 印 力 的 迴 路 控 ,當轉印動作完成後,即利用位於該第一模板 12 制;接著 之 模 具 冷 卻 器 41與 位 於 該 吸 附 板 22之 基 板 冷 卻 器 42進 行 降 ,以令該模具 1 1與基板 2 1之溫度降至適當溫度後,藉該 驅動源 14驅動該轉印單元 10進行脫模,而分離該模具 11與 可成形材料層 23,完成整個轉印程序;此外,於進行該轉 印過程前,可先於該模具11與基板21間塗佈一層高揮發性 之抗沾黏層(未圖示),以幫助脫模。

第2圖所示係為本創作之平行度調整裝置1的第二實施例,相較於該第一實施例,其係將本創作所設計之平行度調整機構27,亦即該包覆有流體25之彈性膜24配置於該轉印單元10,同樣可達平行度調整之效果;該設計係於轉印單元10配置一定位模板28,並將該彈性膜24置於該定位模板28與該第一模板12間,以於進行轉印且該模具11與基板





五、創作說明 (9)

21接觸時,藉其接觸力與該彈形膜 24之可撓性,調整該轉印單元 10之模具 11,以達至平行度與均勻施壓之需求,其構件配置與前述之第一實施例相同,故此處不再另文贅述。

本創作所設計之彈性膜 24亦可同時配置於該轉印單元 10與承載單元 20,亦即同時將其配置於轉印單元 10之定位模板 28與第一模板 12間、以及承載單元 20之第二模板 26與吸附板 22間 (未圖示),而前述所提出的施壓 /受壓配置係為一般習知奈米轉印製程所採之配置,惟本創作仍可運用於各種等效配置上,例如將該基板 21置於轉印單元 10,而該模具 11置於承載單元 20等;同時,前述用以加強水平定位之定位平台 31,亦可加以增設而用於定位該轉印過定位模板,同樣可達至或加強該轉印過程的定位精準性。

綜上所述,本創作之用於奈采轉印的平行度調整裝置,確可改善習知裝置之問題,其特色即在於利用一彈性膜進行平行度調整,並以其所密封之流體提供均勻施壓力,而不需任何外加之平行度調整驅動源,且可降低加工及組裝誤差,進而避免因驅動源振動所造成之問題,同時與人人。 時,兼具有結構簡單、成本低廉、即時響應與低作動複雜性等功效。

惟以上所述者,僅為本創作之具體實施例而已,並非用以限定本創作之範圍,舉凡熟習此項技藝者在本創作所揭示之精神與原理下所完成的一切等效改變或修飾,仍應皆由後述之專利範圍所涵蓋。





圖式簡單說明

【圖式簡單說明】

第1圖係為本創作之平行度調整裝置之第一實施例側 視 圖 ;

第2圖係為本創作之平行度調整裝置之第二實施例側 視 圖 ;

第 3A至 3C圖係為奈米轉印技術之動作流程圖;

第 4圖 係 為 美 國 專 利 第 5,993,189號 案 之 奈 米 轉 印 裝 置 示意圖;

第 5圖 係 為 PCT專 利 第 WO0169317號 案 之 奈 米 轉 印 裝 置 示意圖;

第6圖係為美國專利第6,482,742號案之奈米轉印裝 置示意圖; 以及

第 7圖 係 為 PCT專 利 第 WO0142858號 案 之 奈 米 轉 印 裝 置 示意圖。

- 1 平行度調整裝置
- 模具
- 奈 米 結 構 13
- 15 導引桿
- 2 1 基 板

- 23 可成形材料層
- 25 流 贈
- 2.7 平行度調整機構
- 31 定位平台

- 10 轉印單元
- 12 第一模板
- 驅動源 14
- 承載單元 20
- 22 吸附板
- 24 彈性膜
- 26 第二模板
- 28 定位模板
- 41 模具冷卻器



圖式簡單說明

- 4.2 基板冷卻器
- 55 壓力感測器
- 62 下載台
- 64 基板
- 71 模具基板
- 73 油壓缸活塞
- 75 油壓缸
- 77 油壓缸
- 82 模具
- 84 壓力艙
- 第 出口通道
- 92 壓力艙

- 51 加熱器
- 61 上載台
- 63 模具
- 65 導柱
- 72 基板
- 74 油壓缸活塞
- 76 0形 環
- 81 彈性封套
- 83 基板
- 85 入口通道
- 91 基板
- 93 彈性膜

六、申請專利範圍

1. 一種用於奈米轉印之平行度調整裝置,其包含有:轉印單元,係至少具有一第一模板與固定於該第一模板上的轉印用模具;

承載單元,係至少具有一第二模板與固定於該第 二模板上且塗佈有可成形材料層之基板;

平行度調整機構,係包含一密閉彈性膜及其所包覆之流體,並接置於該第一模板與第二模板之其中至少一者;以及

驅動源,係用以驅動該轉印單元與承載單元之其中至少一者,以令該轉印用模具與該可成形材料層接觸而進行轉印,並藉其接觸使該平行度調整機構受壓,而調整該轉印用模具與該基板間之轉印平行度。

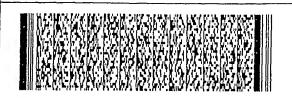
- 2. 如申請專利範圍第 1項所述之平行度調整裝置,其中, 若該平行度調整機構係接置於該第一模板上,則其係 固定於該第一模板與該轉印用模具間,以於受壓時調 整該轉印用模具之平行度。
- 3. 如申請專利範圍第 1項所述之平行度調整裝置,其中,若該平行度調整機構係接置於該第二模板上,則其係固定於該第二模板與該基板間,以於受壓時調整該基板之平行度。
- 4.如申請專利範圍第 1項所述之平行度調整裝置,其中,該平行度調整機構之彈性膜係選自由橡膠、塑膠等高分子材料與其他可撓性結構所組成之組群之一者。
- 5. 如申請專利範圍第1項所述之平行度調整裝置,其中,

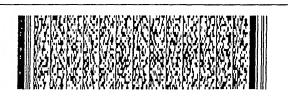


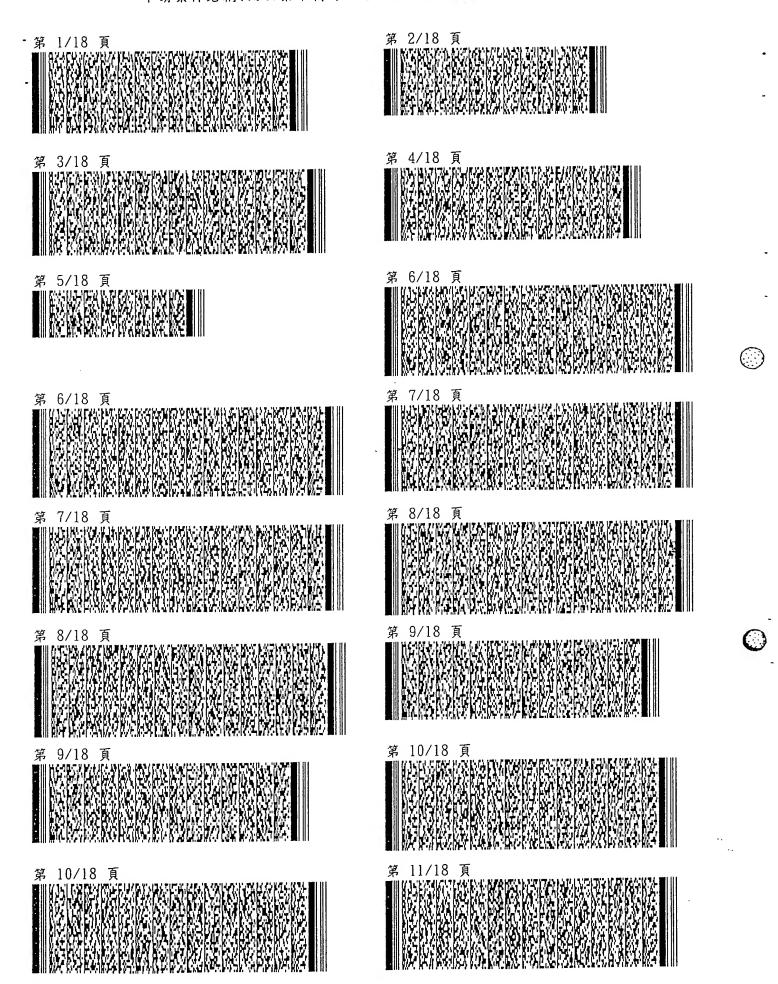


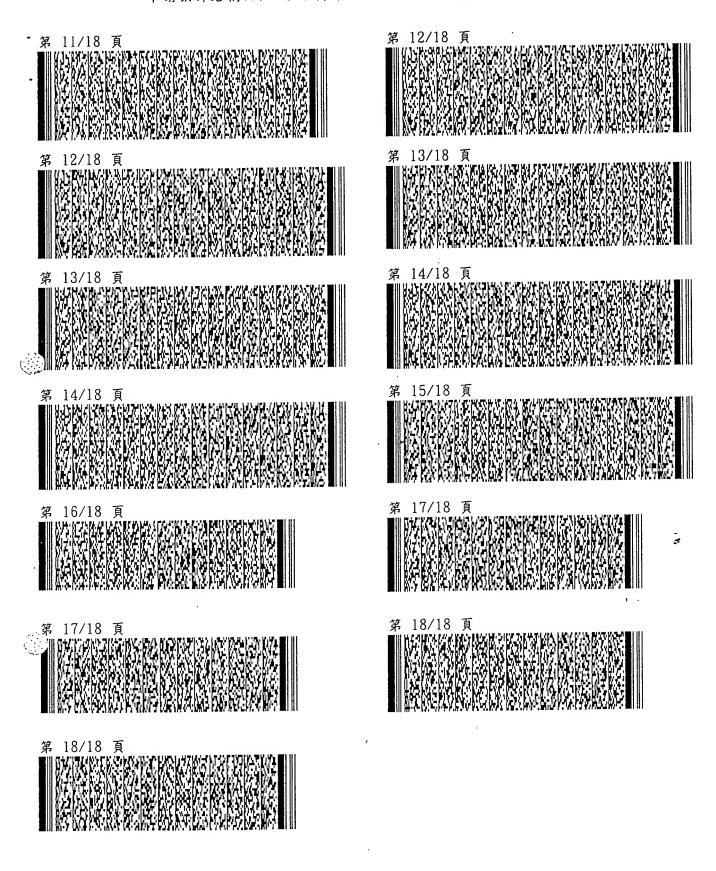
六、申請專利範圍

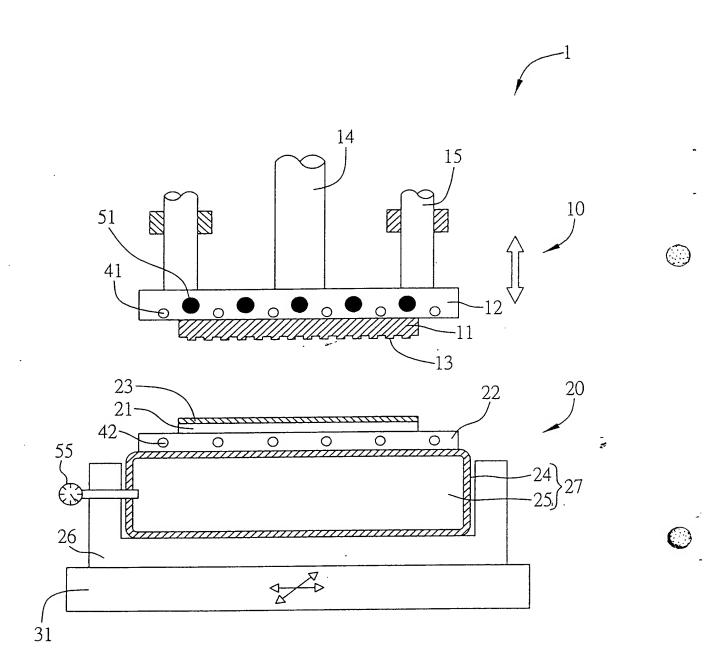
- 該平行度調整機構復包括用以感測其受壓壓力的壓力 感測器,以進行一即時壓力感測。
- 6. 如申請專利範圍第 1項所述之平行度調整裝置,其中:該轉印單元與承載單元之其中至少一者係可接置於一定位平台,以加強轉印時之定位效果。
- 7. 如申請專利範圍第 1項所述之平行度調整裝置,其中,該驅動源係一由線性馬達與油壓缸、或伺服馬達與滾珠導螺桿所組成之傳動單元。
- 8. 如申請專利範圍第 1項所述之平行度調整裝置,其中,該可成形材料層係選自由高分子聚合物、金屬、非金屬等可成形之材料所組成之組群之一者。
- 9. 如申請專利範圍第 1項所述之平行度調整裝置,其中,該可成形材料層與該轉印用模具上係可塗佈一層抗沾黏層。
- 10.如申請專利範圍第 1項所述之平行度調整裝置,其中,該轉印用模具與基板係以真空吸附力、機械力與電磁力其中之一者分別固定於該轉印單元與該承載單元上。
- 11.如申請專利範圍第1項所述之平行度調整裝置,其中該轉印單元與承載單元上係裝設有加熱件,以於進行轉印時升溫至一預定操作溫度。
- 12.如申請專利範圍第 1項所述之平行度調整裝置,其中該轉印單元與承載單元上係裝設有冷卻件,以於完成轉印後降溫至一適當溫度。



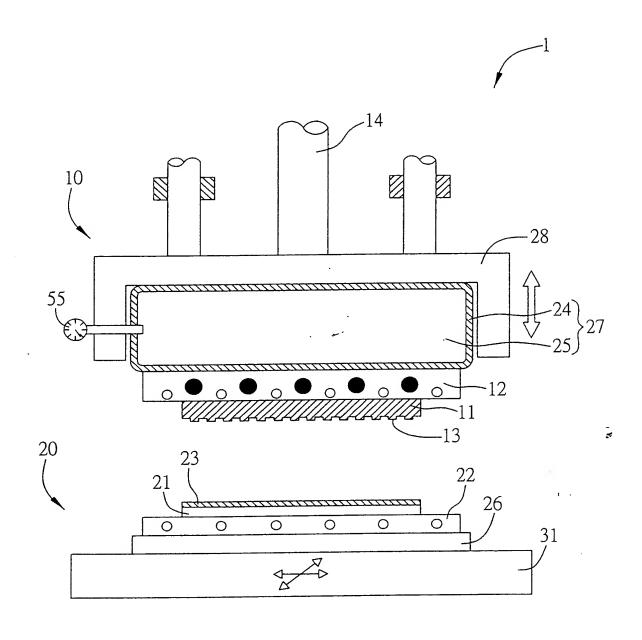




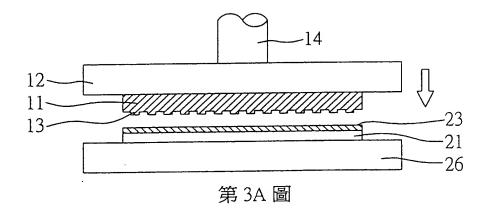


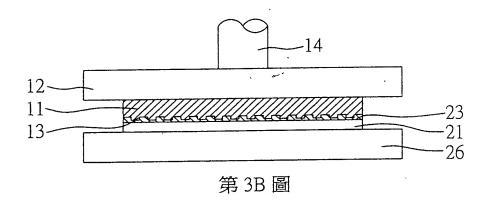


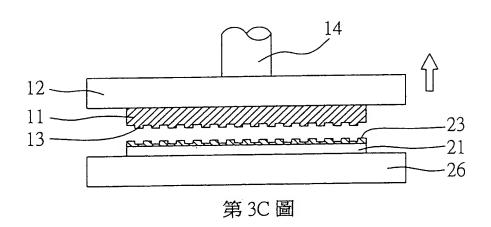
第1圖(代表圖)

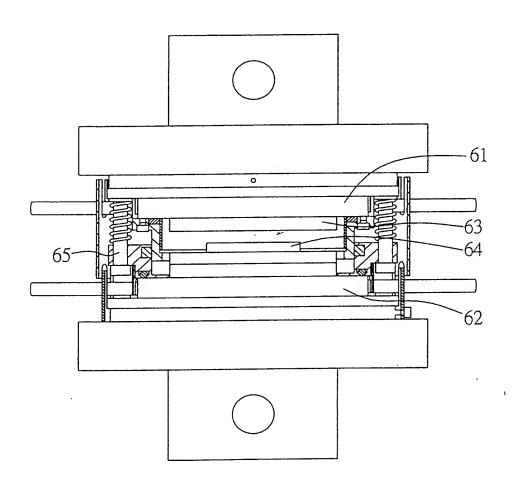


第2圖

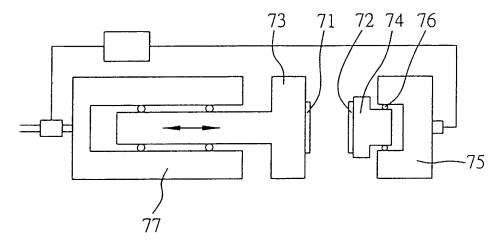




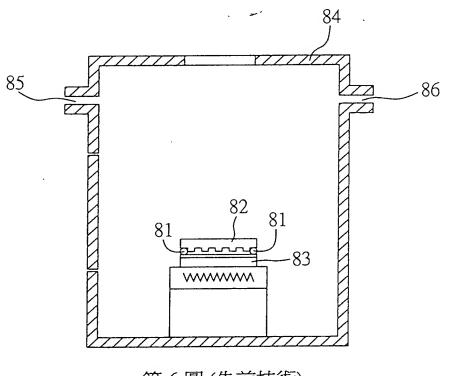




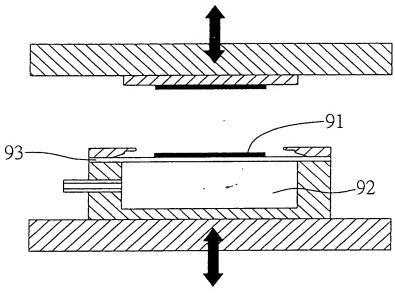
第4圖(先前技術)



第5圖(先前技術)



第6圖(先前技術)



第7圖(先前技術)